

Extension of Annex III and IV of RoHS Directive

Delegated Directive No.	Annex / Anhang	Englisch	Deutsch
2014/1/EU	IV	lead as an alloying element for bearings and wear surfaces in medical equipment exposed to ionising radiation	Blei als Legierungselement für ionisierender Strahlung ausgesetzte Lager und Verschleißflächen in medizinischen Geräten
2014/2/EU	IV	cadmium in phosphor coatings in image intensifiers for X-ray images until 31 December 2019 and in spare parts for X-ray systems placed on the EU market before 1 January 2020	Cadmium in Leuchtstoffbeschichtungen in Bildverstärkern für Röntgenbilder bis zum 31. Dezember 2019 sowie in Ersatzteilen für vor dem 1. Januar 2020 in der EU in den Verkehr gebrachte Röntgenanlagen
2014/3/EU	IV	lead acetate marker for use in stereotactic head frames for use with CT (Computed Tomography) and MRI and in positioning systems for gamma beam and particle therapy equipment	Bleiacetatmarker zur Verwendung in stereotaktischen Kopffrahmen bei der Computertomographie und der Magnetresonanztomographie sowie in Positionierungssystemen für Gammastrahlen- und Partikeltherapiegeräte
2014/4/EU	IV	lead enabling vacuum tight connections between aluminium and steel in X-ray image intensifiers	Blei zur Herstellung vakuumdichter Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl in Röntgenbildverstärkern
2014/5/EU	IV	lead in solders on printed circuit boards, termination coatings of electrical and electronic components and coatings of printed circuit boards, solders for connecting wires and cables, solders connecting transducers and sensors that are used durably at a temperature below – 20 °C under normal operating and storage conditions	Blei in Loten auf Leiterplatten, in der Beschichtung von Anschlüssen von elektrischen und elektronischen Komponenten und in Beschichtungen von Leiterplatten, in Loten zur Verbindung von Drähten und Kabeln, in Loten zur Verbindung von Wandlern und Sensoren, die dauerhaft bei einer Temperatur von unter – 20 °C unter normalen Betriebs- und Lagerbedingungen verwendet werden
2014/6/EU	IV	lead in the surface coatings of pin connector systems requiring nonmagnetic connectors which are used durably at a temperature below – 20 °C under normal operating and storage conditions	Blei in Oberflächenbeschichtungen von Einsteckpressverbindern, die nichtmagnetische Verbinder erfordern und dauerhaft bei einer Temperatur von unter – 20 °C unter normalen Betriebs- und Lagerbedingungen verwendet werden
2014/7/EU	IV	Lead in solders, termination coatings of electrical and electronic components and printed circuit boards, connections of electrical wires, shields and enclosed connectors which are used <ul style="list-style-type: none"> (a) in magnetic fields within the sphere of 1 m radius around the isocentre of the magnet in medical magnetic resonance imaging equipment, including patient monitors designed to be used within this sphere, or (b) in magnetic fields within 1 m distance from the external surfaces of cyclotron magnets, 	Blei in Loten, in der Beschichtung von Anschlüssen von elektrischen und elektronischen Komponenten und von Leiterplatten, in Verbindungen von elektrischen Kabeln, in Abschirmungen und ummantelten Steckverbindern zur Verwendung <ul style="list-style-type: none"> a) in Magnetfeldern innerhalb eines Radius von 1 m um das Isozentrum des Magneten von medizinischen Geräten für die Magnetresonanztomographie, einschließlich der für den Einsatz innerhalb dieses Bereichs konzipierten Patientenmonitore,

		magnets for beam transport and beam direction control applied for particle therapy	oder b) in Magnetfeldern mit höchstens 1 m Abstand von den Außenflächen von Zyklotron-Magneten oder von Magneten für den Strahlentransport und die Strahlenlenkung in der Partikeltherapie
2014/8/EU	IV	lead in solders for mounting cadmium telluride and cadmium zinc telluride digital array detectors to printed circuit boards	Blei in Loten zur Befestigung digitaler Cadmiumtellurid- und Cadmiumzinktellurid-Arraydetektoren auf Leiterplatten
2014/9/EU	IV	lead and cadmium in metallic bonds creating superconducting magnetic circuits in MRI, SQUID, NMR (Nuclear Magnetic Resonance) or FTMS (Fourier Transform Mass Spectrometer) detectors	Blei und Cadmium in metallischen Bindungen zur Herstellung von supraleitenden magnetischen Kreisen in MRI-Detektoren, SQUID-Detektoren, NMR-Detektoren (Kernspinresonanz) oder FTMS-Detektoren (Fourier-Transform-Massenspektrometer)
2014/10/EU	IV	lead in alloys, as a superconductor or thermal conductor, used in cryo-cooler cold heads and/or in cryo-cooled cold probes and/or in cryo-cooled equipotential bonding systems, in medical devices (category 8) and/or in industrial monitoring and control instruments	Blei in Legierungen als Supraleiter und Wärmeleiter zur Verwendung in Kühlköpfen von Kryokühlern und/oder in kryogen gekühlten Kältesonden und/oder in kryogen gekühlten Potentialausgleichssystemen, in medizinischen Geräten (Kategorie 8) und/oder in Überwachungs- und Kontrollinstrumenten in der Industrie
2014/11/EU	IV	hexavalent chromium in alkali dispensers used to create photocathodes in X-ray image intensifiers until 31 December 2019 and in spare parts for X-ray systems placed on the EU market before 01 January 2020	Sechswertiges Chrom in Alkali-Dispensern zur Verwendung bei der Herstellung von Fotokathoden in Röntgenbildverstärkern bis zum 31. Dezember 2019 und in Ersatzteilen für vor dem 01. Januar 2020 in der EU in den Verkehr gebrachte Röntgenanlagen
2014/12/EU	IV	lead in solders on printed circuit boards of detectors and data acquisition units for Positron Emission Tomographs which are integrated into Magnetic Resonance Imaging equipment	Blei in Loten auf Leiterplatten von Detektoren und Datenerfassungseinheiten für in Magnetresonanztomographen integrierte Positronenemissionstomographen
2014/13/EU	IV	lead in solders on populated printed circuit boards used in Directive 93/42/EEC class IIa and IIb mobile medical devices other than portable emergency defibrillators	Blei in Loten auf bestückten Leiterplatten zur Verwendung in mobilen Medizinprodukten der Klassen IIa und IIb der Richtlinie 93/42/EWG mit Ausnahme von tragbaren Notfalldefibrillatoren
2014/14/EU	III	exemption for 3,5 mg mercury per lamp in single capped compact fluorescent lamps for general lighting purposes < 30 W with a lifetime equal to or above 20 000 h	Verwendung von 3,5 mg Quecksilber je Lampe in einseitig gesockelten Kompaktleuchtstofflampen für allgemeine Beleuchtungszwecke < 30 W mit einer Lebensdauer von 20 000 Stunden oder mehr
2014/15/EU	IV	lead, cadmium and hexavalent chromium in reused spare parts, recovered from medical devices placed on the market before 22 July 2014 and used in category 8 equipment placed on	Blei, Cadmium und sechswertiges Chrom in wiederverwendeten Ersatzteilen, die aus vor dem 22. Juli 2014 in den Verkehr gebrachten medizinischen Geräten ausgebaut

		the market before 22 July 2021, provided that reuse takes place in auditable closed-loop business-to-business return systems, and that the reuse of parts is notified to the consumer	werden und in vor dem 22. Juli 2021 in den Verkehr gebrachten Geräten der Kategorie 8 verwendet werden, sofern die Wiederverwendung in einem überprüfbar geschlossenen zwischenbetrieblichen System erfolgt und den Verbrauchern mitgeteilt wird, dass Teile wiederverwendet wurden
2014/16/EU	IV	lead as an activator in the fluorescent powder of discharge lamps when used for extracorporeal photopheresis lamps containing BSP (BaSi ₂ O ₅ :Pb) phosphors	Blei als Aktivator im Leuchtstoffpulver von Gasentladungslampen, die als Bariumsilikat-Leuchtstoffe (BaSi ₂ O ₅ :Pb) enthaltende Lampen zur extrakorporalen Photopherese verwendet
2014/69/EU	IV	lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC for industrial monitoring and control instruments	Blei in dielektrischer Keramik in Kondensatoren für eine Nennspannung von weniger als 125 V AC oder 250 V DC für industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente
2014/70/EU	IV	lead in micro-channel plates (MCPs)	Blei in Mikrokanalplatten (MCP)
2014/71/EU	IV	lead in solder in one interface of large area stacked die elements	Blei in Loten in einer Schnittstelle von großflächigen Stacked-Die-Elementen
2014/72/EU	IV	lead in solders and termination finishes of electrical and electronic components and finishes of printed circuit boards used in ignition modules and other electrical and electronic engine control systems	Blei in Loten und Anschlussbeschichtungen von elektrischen und elektronischen Bauteilen und Beschichtungen von Leiterplatten zur Verwendung in Zündungsmodulen und anderen elektrischen und elektronischen Motorsteuerungssystemen
2014/73/EU	IV	lead in platinized platinum electrodes used for conductivity measurements	Blei in platinieren Platinelektroden zur Verwendung für Leitfähigkeitsmessungen
2014/74/EU	IV	lead used in other than C-press compliant pin connector systems for industrial monitoring and control instruments	Blei zur Verwendung in Einpressteckverbindern mit flexibler Zone (andere als solche des Typs „C-Press“) für industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente
2014/75/EU	IV	mercury in cold cathode fluorescent lamps (CCFLs) for back-lighting liquid crystal displays, not exceeding 5 mg per lamp, used in industrial monitoring and control instruments placed on the market before 22 July 2017	Quecksilber in Kaltkathoden-Fluoreszenz-Lampen (CCF-Lampen) für hintergrundbeleuchtete Flüssigkristallanzeigen mit nicht mehr als 5 mg je Lampe zur Verwendung in vor dem 22. Juli 2017 in Verkehr gebrachten industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten
2014/76/EU	III	Mercury in hand crafted luminous discharge tubes (HLDTs) used for signs, decorative or architectural and specialist lighting and light-artwork	Quecksilber in handgefertigten Leuchtstoffentladungsröhren zur Verwendung in Anzeigen, Dekorations-, Architektur- und Spezialbeleuchtungen und in Lichtkunstwerken